



半導体製造装置フィールドアプリケーションエンジニア（メカ）

TOWA株式会社での募集です。製造技術（機械）のご経験のある方は歓迎です。

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

TOWA株式会社

求人ID

1615573

業種

機械

雇用形態

正社員

勤務地

京都府

給与

500万円～700万円

勤務時間

08:30～17:30

休日・休暇

【有給休暇】初年度10日1か月目から年間123日（＋一斉年次有給休暇取得日2日）週休2日制（基本土日祝、弊社カレンダー…）

更新日

2026年10月01日 16:09

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

ビジネス会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

専門学校卒

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2276576】

半導体製造装置のフィールドアプリケーションエンジニア（メカ）として、お客様との密なコミュニケーションを通じた技術サポートを担っていただきます。具体的には、装置の導入支援や生産時のカスタマイズや技術サポートにおいて、技術的なコミュニケーションを通じて得るお客様のニーズや課題を開発部門にフィードバックし、新製品・新機能の提案を行います。お客様と信頼関係を深め、専門知識や折衝能力を高めることで、将来的にはプロジェクトリーダーや技術スペシャリスト、マネージャーとしてご活躍いただけるステージがございます。

お客様の工場に設置する半導体製造装置の導入支援
お客様のニーズから新しい機能の提案

スキル・資格

< 必須 >

自動機（FA）の知見・設計経験・立ち上げ経験のいずれかをお持ちの方
協調性、自主性と責任感があり、チームで成果をあげる働き方に魅力を感じる方
技術英語（初級）

< 歓迎 >

半導体製造装置のフィールドアプリケーションエンジニア経験

装置の設置・調整・トラブルシューティング経験

機械工学、電気電子工学、物理学等の一般知識

技術的な問題解決能力

技術英語（中級以上）

< 求める役割 >

お客様との信頼関係を大切に、お客様のニーズや技術的な課題解決を的確に捉え、粘り強く課題解決に取り組み、最適なソリューションの提供に価値を感じる方。現状に留まることなく常に進化を追求し、新しい知識や技術の習得に意欲的な方。

会社説明

【半導体事業】半導体製造装置（モールドイング装置・シンギュレーション装置）・超精密金型の開発・製造・販売【化成
品事業】ファインプラスチック成形品の製造・販売【新事業】超精密加工技術をコアとした商品の発売【レーザー事業】
レーザー加工装置の販売